

简介

TACFlux®26S是无人添加卤素的免洗型返修助焊剂，其残留物温和、透明。残留物的减少优化了底部填充剂的粘附性，并且减少了填充剂在固化时可能产生的排气现象。

特点

- 无卤素 - 无人添加卤素
- 适用于无铅合金
- 与底部填充胶兼容
- 浸蘸时几乎无桥连
- 为返修设计
- 残留低
- 无气泡（真空）包装

属性

| 属性 | 数值 | 测试方法 |
|-------------------|---|--|
| 助焊剂类型 | RELO | J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 & 2.3.33) |
| 颜色 | 淡黄色 | 肉眼观察 |
| 典型黏度 | 13 kcps | Brookfield HB DVII+-CP (20rpm) |
| 典型酸值 | 39 mg KOH/g | 滴定法 |
| 表面绝缘电阻 SIR (ohms) | 合格 (>10 ⁸ : 7 天后, 85°C, 相对湿度85%) | J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24) |
| 回流后残留物比重 | < 10% | TGA |
| 保质期 | 6个月 (0-30°C) | 黏度变化/显微镜检查 |

所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

应用

TACFlux®26S是在氮气回流氛围中（含氧量不超过100ppm）使用的助焊剂。某些情况下可以在空气环境中使用，但惰性气体氛围将提供最优结果。

TACFlux®26S可被用于多种表面（包括化银板、铜-OSP、AuNi、AuPdNi），并与所有标准的倒装芯片焊料兼容。

清洁

TACFlux®26S专门为免洗应用设计。如果需要，助焊剂可以用市售助焊剂清洗剂去除。适配清洗剂的选择请咨询钢泰公司的工程师。



兼容性

通过检测回流后的助焊剂与固化后的底部填充剂交界面的剪切强度，可以确定倒装芯片助焊剂的残留物与环氧基毛细底部填充剂的兼容性。TACFlux®26S在胺基和酸酐基的毛细底部填充剂上所取得的结果最好。

储存

TACFlux®26S（注射剂装和筒装）应尖端朝下，储存在温度为0°C至30°C的环境里，以达到最长保质期。使用前，请确保TACFlux®26S的温度升高至环境温度。

包装

TACFlux®26S通常使用10cc和30cc的注射器包装。其他包装也可应求提供。

表格编号: 99073 (SC A4) R2

本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

From One Engineer To Another

立即联络: china@indium.com

更多详情: www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2017 钢泰公司